

【報導相關之各位】

2010 年 8 月 30 日

Tanaka Holdings Co., Ltd.

Tanaka Precious Metals

田中電子工業株式會社、 2008 年 1 月～2010 年 6 月 Bonding Wire 出貨量發表

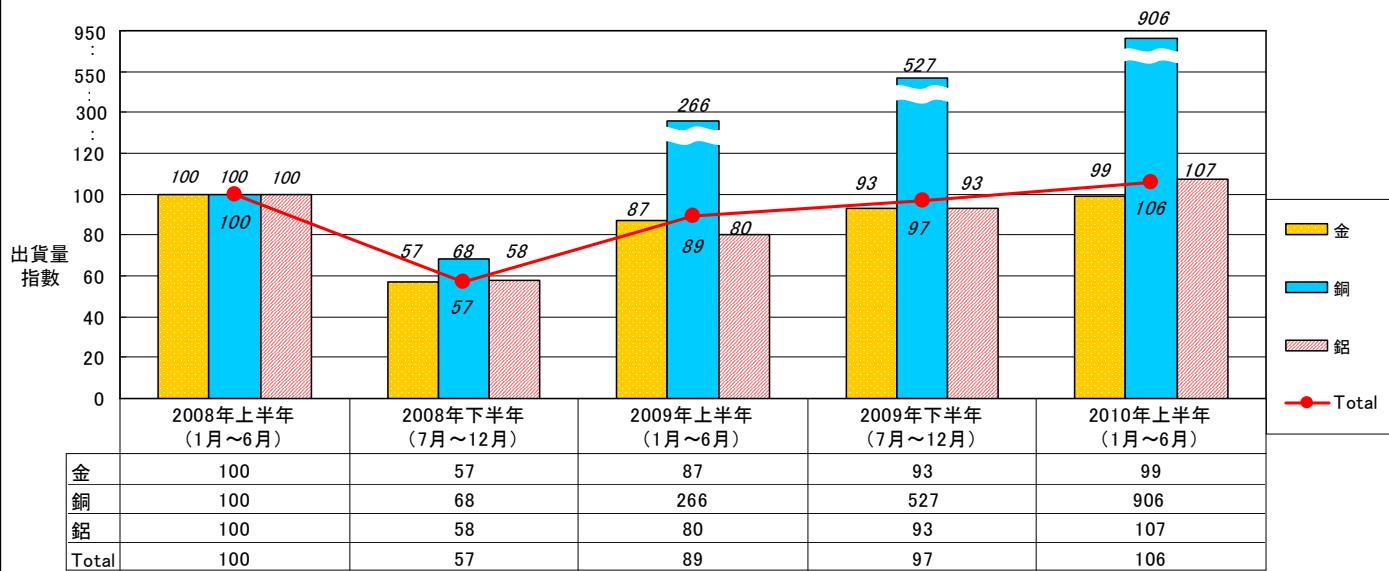
- 雷曼事件後出貨量減半，但於 2010 年上半年，出貨量回復並超越雷曼事件前。
- 相較於 2008 年上半年，銅之出貨量擴展為 906%！因為金價高漲，銅正式成為替代金屬。
- 因為功率元件（Power device）及太陽能電池等需求增加，擴展鋁之出貨量。

Tanaka Holdings Co., Ltd. (總公司：千代田區丸之内、代表取締役社長：岡本英彌) 發表從 2008 年 1 月起至 2010 年 6 月為止，Bonding Wire 市場佔有率世界排名第一的田中貴金屬集團田中電子工業株式會社 (總公司：東京都千代田區、代表取締役社長：笠原康志) 金、銅及鋁 Bonding Wire 出貨量 (指數) 之匯整資料。

【(金・銅・鋁) 整體出貨量趨勢】

以雷曼事件前的 2008 年上半年之出貨量為基準，Bonding Wire 之整體出貨量於雷曼事件後的 2008 年下半年減少至 57%，跌入最低點。之後，隨著進行顧客庫存的改善，於 2009 年上半年之後的出貨量持續回復，於 2010 年上半年終於回復至 106%，出貨量超越雷曼事件前。

Bonding Wire 出貨量趨勢
以 2008 年上半年(1 月～6 月) 出貨量為 100 之指數



【金 Bonding Wire 出貨量趨勢】

以雷曼事件前的 2008 年上半年之出貨量為基準，2008 年下半年減少至 57%，跌入最低點。之後，出貨量開始有回復傾向，金的國際價格不斷處於持續刷新市場最高價的狀態，於 2010 年上半年回復至幾乎與雷曼事件前一樣的數值（99%）。

因為金具有高度耐蝕性及高度導電性等絕佳特性，因此一向為 Bonding Wire 的主力項目，牽動整體之出貨量，因此依然保持高度之需求量。

【銅 Bonding Wire 出貨量趨勢】

雖然在雷曼事件後的 2008 年下半年減少至 68%，但因為金價持續高漲中，銅以比金低價的替代金屬受到矚目，從 2009 年上半年起出貨量急速上升。於 2010 年上半年上升至 906%。但與金相較之下，因為銅不耐溫度變化及不耐濕度，有容易產生氧化之缺點，仍然存在品質穩定性低的問題，但目前情勢致力於提升銅的加工技術，且銅做為金的替代金屬之需求量亦高，今後仍可望增加出貨量。

【鋁 Bonding Wire 出貨量趨勢】

與金及銅一樣，在雷曼事件的 2008 年下半年減少至 58% 為最低點，之後出貨量轉為回復，於 2010 年上半年回復並超過雷曼事件前的 106%。鋁為化學穩定性高之材料，與金相較之下，價格便宜且容易加粗線徑，因此大電流能夠通過，在混合動力汽車（HV）的 IGBT^{※1} 等功率元件（Power device）領域上需求擴大。

另外，再加上太陽能電池及環保商品、因應環境對策的製品需求擴大，搭載變頻器的家電製品在中國普及等，兼顧環保及節能之意識高漲，鋁 Bonding Wire 的出貨量目前也在順利持續擴展當中。

目前，田中電子工業加強銷售採用獨自合金技術的銅製導線「CLR-1（Clear One）^{※2}」及鋁 Bonding Wire 以因應市場需求，今後也將掌握市場動向，發展技術開發。

※1 IGBT：Insulated gate bipolar transistor 之簡稱。結合場效應電晶體的絕緣閘雙極電晶體。因為電壓控制、開關頻率高，因此通常用於高電壓和高電流的切換頻率等應用上。

※2 CLR-1：藉由田中電子工業獨自開發的合金技術，銅表面上生成鈀薄膜，提高耐腐蝕性，具備接著性佳、穩定性高且高機能銅製導線。

■ Tanaka Holdings Co., Ltd. (統籌田中貴金屬集團之控股公司)

總公司：東京都千代田區丸之内 2-7-3 東京 Building 22F

代表：代表取締役社長 岡本 英彌

創業：1885 年 設立：1918 年

資本額：5 億日圓

員工人數：3,434 名（2009 年度集團連結）

營業額：7,102 億日圓（2009 年度集團連結）

集團主要營業內容：貴金屬鑄塊（白金、金、銀、其他）以及各種工業用貴金屬製品之製造、銷售、進出口及貴金屬之回收、提煉

HP 官方網站：<http://www.tanaka.co.jp>

工業產品網站：<http://pro.tanaka.co.jp>

■ 田中電子工業株式會社

總公司：東京都千代田區丸之内 2-7-3 東京 Building 22F

代表：代表取締役社長 笠原 康志

設立：1961 年 資本額：18 億 8 千萬日圓

員工人數：133 名（2009 年度） 營業額：399 億 8 千萬日圓（2009 年度）

營業內容：各種 Bonding Wire 之製造

HP 官方網站：<http://www.tanaka-bondingwire.com/>

<關於田中貴金屬集團>

田中貴金屬集團自 1885 年（明治 18 年）創業以來，營業範圍向來以貴金屬為中心，展開廣泛活動。於 2010 年 4 月 1 日，以 TANAKA HOLDINGS Co., Ltd. 做為控股公司（集團母公司）的形式，完成集團組織重組。同時為了加強內部控制制度，藉由有效進行迅速經營及機動性業務，以提供顧客更佳的服務為目標。並且，以身為貴金屬相關的專家集團，集團各公司攜手合作提供多樣化的產品及服務。

在日本國內，以最高等級的貴金屬佔有率為傲的田中貴金屬集團，長年於提供從工業用貴金屬材料的開發到穩定供應、裝飾品及活用貴金屬的儲蓄商品方面不遺餘力。今後也以身為貴金屬專業集團，集團全體將不斷地為寬裕豐富的生活貢獻一己之力。

田中貴金屬集團核心 8 家公司如下所示。

- TANAKA HOLDINGS Co., Ltd. (純粹控股公司)
- 田中貴金屬工業株式會社
- 田中貴金屬販賣株式會社
- 田中貴金屬 International 株式會社
- 田中電子工業株式會社
- Electroplating Engineers of Japan Ltd.
- 田中貴金屬 Jewelry 株式會社
- 田中貴金屬 Business service 株式會社

<報導相關諮詢處>

CS Center, 田中貴金屬 International 株式會社(TKI)

e-mail: tki-contact@ml.tanaka.co.jp